新聞稿

Manz 亞智科技成功交付全球首台 310mm × 310mm 面板級封裝 ECD 量產設備

【台灣桃園，2026 年 6 月 15 日】專注於半導體面板級封裝設備研發與製造的 Manz 亞智科技，成功交付全球首台 310mm × 310mm 面板級封裝（PLP）電化學沉積（Electrochemical Deposition, ECD）量產設備，進一步擴展先進封裝關鍵製程設備版圖，展現自主研發、製程與系統整合及量產導入的全方位整合實力。

全新 ECD 平台可靈活支援玻璃與金屬方形載具，並整合重佈線層（RDL）關鍵濕製程技術，提供適用於 FOPLP、CoPoS 及 TGV 等先進封裝架構的量產解決方案。310mm × 310mm 方形載具平台兼具製程彈性、面積利用率與量產良率優勢，正逐步成為面板級封裝關鍵技術路徑，支援 AI、高效能運算（HPC）、高頻寬記憶體（HBM）及高速傳輸晶片等高成長應用需求。

全球高階封裝技術與先進製程高度連動，產能持續集中於台灣，帶動整體半導體供應鏈向先進製程與先進封裝協同升級。Manz 亞智科技透過自主研發能力，並與國際 IDM 及封裝客戶緊密合作，加速關鍵技術迭代與量產導入，持續強化在全球面板級封裝設備供應鏈中的角色與競爭力。

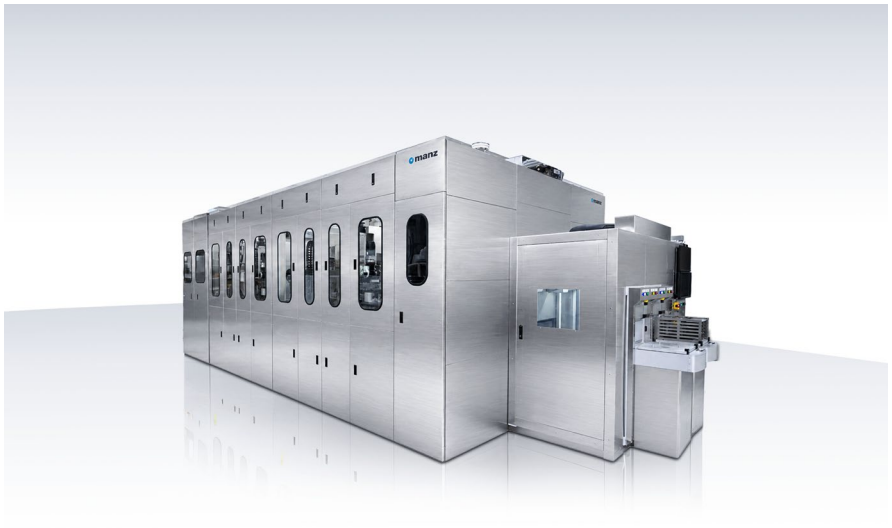
以 ECD 設備為核心，Manz 亞智科技此次的出機還進一步整合清洗、顯影、蝕刻及剝膜等關鍵濕製程設備，並支援旋轉噴灑（Spin）與面噴灑（Spray）雙製程模式，打造完整的 310mm × 310mm 面板級 RDL 製程解決方案「Omni 310x」。

Omni 310x (310mm × 310mm) 正式加入既有 Omni 510x（510mm × 515mm）及 Omni 700x（700mm × 700mm）系列，透過多尺寸平台的系統化布局，建構完整的面板級封裝量產平台。以模組化設計架構與彈性自動化整合能力為基礎，可依不同客戶的產品架構、封裝技術與產能需求進行客製化配置，提供更具彈性的技術路徑，支援從研發驗證、試量產到大規模生產的各階段需求，持續強化 Manz 亞智科技於全球面板級先進封裝設備市場的競爭優勢。

Manz 亞智科技總經理林峻生表示：「全球首條 Omni 310x 成功出機並導入客戶產線，顯示市場對兼具高彈性與量產導向的先進封裝製程平台需求持續快速成長。隨著先進封裝逐步成為推動 AI 與高效能運算架構演進的核心技術，設備平台的製程可控性、擴展性，以及與量產節點的高度對接能力，已成為產業競爭關鍵。」

林峻生進一步指出：「Manz 亞智科技以全球先進設備供應商標準持續推進技術發展，深化 ECD 與濕製程整合能力，協助客戶提升製程效率、良率穩定性與量產導入速度，加速 FOPLP、CoPoS 及 TGV

等次世代封裝應用落地，強化全球半導體設備供應鏈韌性與競爭力。透過 310mm、510mm 與 700mm 多尺寸平台布局，提供涵蓋製程開發、技術驗證至量產導入的完整設備解決方案，使客戶以一致技術路徑實現規模化導入。Omni x 系列平台的發展策略將支持新世代封裝應用在效率與可預期性基礎上完成產能擴張，實現階段性規模成長。」



▲ Manz 亞智科技全球首台 310mm × 310mm 面板級封裝 ECD 量產設備。

新聞稿

關於 Manz 亞智科技

Manz 亞智科技提供基於電化學沉積(ECD)、化學濕製程、噴墨印刷、自動化及軟體整合核心技術的半導體設備與解決方案。我們的核心技術應用於生產製造先進封裝（ FOPLP / CoPoS ）及 IC 載板（玻璃載板及有機載板），支援客戶從研發到大規模量產。透過系統解決方案、代工製造及銷售代理，我們協助客戶加快產品上市速度、提升良率，並在快速發展的半導體產業中保持競爭力。

www.manz.com.tw

媒體聯繫人:

Manz 亞智科技

市場行銷暨公關部處長 / 黃筑青

電話: 03 452 9811 ext. 3399

E-Mail: yvonne.huang@manz.com